

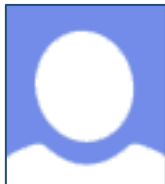
【C-3】装置・プロセス・実装技術が AI 最前線を支える

(敬称略)

10月30日(金) 15:15-17:30

セッションチエアマン： 森 義弘(株)SCREEN セミコンダクターソリューションズ)・廣田 良浩(ワイドヴィル)

◆ 半導体製造装置メーカーの脱炭素の挑戦：SCREEN の SBTi 目標と環境負荷低減の取り組み(仮題)



株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ
R&D 戦略統轄部
グリーン戦略部
環境サステナビリティスペシャリスト
中川 真一

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

◆ 高速インフラ社会に貢献するプラズマプロセス技術(仮題)



SPP テクノロジーズ株式会社
プロセスエンジニアリング部
シニアマネージャー
米倉 和賢

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

◆ AI 技術を支える半導体メモリのスケーリングに向けたプロセスおよび材料の革新



東京エレクトロン株式会社
デバイス技術ソリューション企画部
メモリテクノロジープロジェクト
エキスパート
大池 昇

[講演要旨]

AI の進展に伴い、メモリには高性能化と大容量化への要求が高まっている。本講演では、メモリ進化を支えるプロセス技術および材料革新を概説する。DRAM では、高アスペクト比キャパシタ形成に向けた HAR エッチング技術、低リークを実現する high-k 膜スタック、VCT に向けたボンディング技術、さらに 3D DRAM で必要となる新規プロセス手法を取り上げる。3D NAND では、縦方向・横方向のスケーリングに伴う課題に対し、HAR 加工の高スループット化、新チャネル材料、CT 分断、低抵抗 WL メタルについて紹介する。

[講演者プロフィール]

2007 年 3 月、北海道大学大学院情報科学研究科博士課程修了。株式会社東芝に入社し、2D/3D NAND およびエマージング・メモリの開発に従事。2021 年 1 月より東京エレクトロン株式会社に在籍し、デバイス技術ソリューション企画部にてメモリ関連のコポレート開発戦略に携わり、現在に至る。

※本講演に興味を持たれた方は、こちらの講演もご覧になっています。

【C-1】 AI 時代の勝者を探る

【C-2】 AI 時代の半導体最前線を探る